

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	华安基金、申万菱信、长城基金、博时基金、太平资产、交银施罗德基金、富国基金、华泰柏瑞、万家基金、鹏华基金、银华基金、中银基金、国泰海通证券
时间	2026年6月22日（星期一）至2026年6月24日（星期三）
形式	线上通讯
上市公司接待人员姓名	董事会秘书边冬瑞、投资者关系管理周文 长兴半导体销售总监李钊
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司情况介绍</p> <p>公司于1996年在深交所上市，2023年，公司依法启动破产重整程序，同年12月29日重整计划执行完毕。重整完成后，控股股东变更为湖南天象盈新科技发展有限公司，公司治理结构全面重塑，历史债务包袱大幅减轻，为战略转型奠定了更为优化的财务基础与资本运作条件。新任管理层在产业投资、资本运作和企业管理方面具有丰富经验，2025年6月公司更名为“北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司”，确立了“固地产之基、塑文旅之魂、探新质无界”的战略转型规划。</p> <p>未来，公司将坚定不移地推进战略转型，以“科技拓维、文旅铸魂、资管强基”的三核驱动战略为引领，构建科技、文旅、资管深度融合、协同共生的产业新格局，并积极推动现有地产板块去化及逐步剥离，聚焦科技和文旅两大成长性赛道，逐步实现从重资产开发商向科技驱动型企业的根本性转型。在科技板块的战略落地上，公司于2025年10月与相关方签署股权收购意向协议，拟收购长兴半导体控制权；2026年1月27日、2026年2月12日，公司分别召开董事会和股东会，审议通过了收购长兴半导体60%股权的议案；2026年4月，长兴半导体56.25%股权完成交割过户，长兴半导体纳入公司合并报表范围。</p> <p>二、提问交流环节</p> <p>问题1：公司基于什么考虑收购的长兴？</p> <p>答复：公司把握AI技术革命驱动的半导体存储行业历史性机遇，AI大模型与新兴场景催生海量存储需求，技术迭代推动高性能存储芯片与先进封装应用加速，国家政策支持半导体自主可控与国产替代进程，叠加中国庞大市场需求与产业链协同优势，驱动存储</p>

行业进入黄金发展期。

长兴半导体为国家专精特新“小巨人”企业，在存储芯片封装测试领域已形成多叠 Die 封装、晶圆修复、测试等核心技术储备，产品涵盖 NAND Flash 和 DRAM 存储芯片及高性能存储模组，其全链条能力与核心技术储备，将助力公司切入高增长赛道、构筑技术壁垒，充分分享行业红利。

问题 2：西宁房地产资产出表的目的和考虑是什么？

答复：本次子公司出表，是公司基于整体发展战略审慎研判后的重要举措，高度契合当前聚焦主责主业、优化资源配置的战略方向。此举能够有效降低公司整体负债规模，优化资产负债结构，进而显著降低合并报表口径的资产负债率，增强财务稳健性与抗风险能力。一方面，助力公司盘活沉淀资源、提升资产周转效率，另一方面，也为后续聚焦高增长赛道，如半导体存储产业，提供充足的支持与保障。这一系列举措既符合监管要求，又有利于维护全体股东利益，为长期可持续发展奠定坚实基础。

问题 3：长兴半导体剩余 40% 股份的计划 and 安排。

答复：未来公司将结合整体战略需要，并根据长兴半导体的后续经营情况、业绩承诺完成情况，就是否开展剩余股权的收购进行综合研判，如相关事项达到信息披露标准，公司将严格按照上市公司监管规定履行审议程序及信息披露义务。

问题 4：夏少杰股份变更为什么还没有完成？

答复：经向长兴半导体及夏少杰本人核实，因办理工商变更尚需取得税务部门出具的完税证明，目前相关税务手续正在办理中，公司将持续跟进，积极推进，如相关事项达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。

问题 5：长兴半导体 DRAM 和 NAND 产品形态分别是什么？

答复：DRAM 方面，聚焦 DDR5、RDIMM DDR5 系列产品；NAND 方面，覆盖 SSD、U 盘、SD 等产品。

问题 6：为什么客户选你们的存储产品？公司的竞争优势有哪些？

答复：公司竞争优势主要体现在以下方面：一是技术优势，公司自主研发 DRAM 颗粒测试固件算法，同时掌握 NAND 晶圆修复技术，有效提升良率、降低单位成本，并能实现不同客户颗粒性能的精准匹配，在保证产品性能的基础上形成价格竞争优势；二是交付优势，公司可根据客户生产节奏主动加快产品导入，供应保障能力突出；三是适配优势，公司具备较强的客户协同开发能力，可快速响应不同服务器厂商的定制化需求。

问题 7：存储产品后续战略重心是哪块？

答复：AI 大模型训练对高带宽、低延迟存储的需求呈指数级增长，GPU 集群的数据吞吐瓶颈正从算力侧向存储侧转移；同时，AI 推理逐步从云端向端侧渗透，AI PC 及 AI 手机等终端将拉动消费级大容量、高速存储需求。公司将以此为契机稳步扩大企业级产品规模，同时巩固并提升消费级产品基本盘。

问题 8：长兴半导体现有库存是否充足？

	<p>答复：公司控股子公司长兴半导体目前存货处于合理区间，能够满足现阶段订单履约需求。存货管理方面，公司根据下游客户需求预测、产线排产计划及供应链备货周期，对原材料、在制品及成品库存实施动态管理，兼顾资金占用效率与出货保障能力。</p> <p>问题 9：公司未来研发投入方向？</p> <p>答复：公司已实现 U 盘 MCU 芯片的自主研发，在芯片设计、固件开发及核心算法层面均形成自有技术闭环，摆脱了外购主控方案对产品定义能力和成本端的制约。公司将从已跑通的消费级主控技术积累出发，向工业级纵深延伸，逐步构建覆盖消费、工业等多应用场景的存储控制器芯片产品矩阵，持续强化在存储半导体产业链的核心竞争力。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无